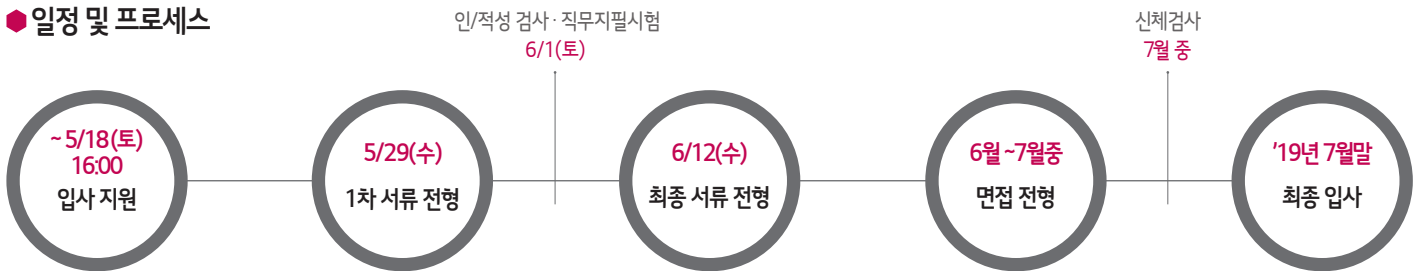


2019년 상반기 신입사원 채용

● 지원 자격

- 대상2019년 8월 졸업 예정자 및 기졸업자(학사/석사/박사)로서 '19년 7월 중 즉시 입사가 가능한 자
- 학위국내/해외에서 학사/석사/박사 또는 이와 동등한 효력이 인정되는 자격을 취득(예정)한 자
- 최종 학위 및 졸업 예정일은 반드시 해당 학위 졸업 가능 여부와 시점을 감안하여 작성해 주시기 바랍니다.
- 병역군필자 또는 면제자에 한합니다.
- 전문연구요원의 경우, 지원시점 기준 본인이 T/O를 소지한 경우에 지원 가능하며, 자사의 신규편입 T/O는 없습니다.
- 기타
 - 해외 여행에 결격 사유가 없는 경우에 한합니다.
 - 산학장학생은 별도 모집 프로그램으로 선발합니다.
 - 입사지원서 및 채용 전형 과정에서 허위 사실이 발각될 경우는 입사가 취소될 수 있습니다.
 - 졸업예정자의 경우 입사 후 3개월 내 학위증명서를 제출하지 못할 시 입사가 취소될 수 있습니다.
 - 취업 보호 대상자(보훈 대상자/장애인)는 관련 법규 등에 의거하여 우대합니다.
* 단, 보훈대상자의 경우 면접 시 취업 지원 대상자 증명서 제출자에 한합니다.
 - R&D직군의 경우 어학 점수를 입력하셔도 서류전형에는 반영하지 않습니다.
* 단, 면접 대상자에 한하여 별도 어학 성적을 요청 할 수 있으며, 면접 시 영어 면접을 별도 진행합니다.
 - 입사 지원서 작성시 공학인증제는 해당자만 체크해주시기 바랍니다.

● 일정 및 프로세스



- 1차서류 전형입사지원서를 기준으로 지원 분야에 해당하는 필요 역량을 갖추었는지를 판단
- 인/적성 검사LG Way 와의 적합성 확인 및 언어/수리 등 기본 역량 평가

구분	검사 내용	문항 수	소요 시간
인성검사 (LG Way Fit Test)	지원자와 LG Way 간의 적합성 확인	342문항	50분
적성 검사*	언어이해/ 언어추리/ 인문역량/ 수리력/ 도형추리/ 도식적추리	125문항	140분

* 문항예제는 careers.lg.com에서 확인할 수 있습니다.

직무지필시험

기본적인 직무 능력을 갖추었는지를 평가

직무	검사 내용	문항 수	소요 시간	응시일
R&D_SW	C, JAVA 프로그래밍 관련	70 문항	100분	6월 1일(토) 인/적성 검사와 동일한 날 실시
R&D_HW	전기공학, 전자공학	80문항	100분	
R&D_기구	기계공학	40문항	50분	

* 직무지필 시험은 1지망 직무 기준으로 실시합니다. (지원서 접수 마감 이후 변경 불가합니다.)
* 위 명시된 직무 외에는 직무지필시험을 진행하지 않습니다. (인/적성 검사만 시행)

면접 전형

직무별 다양한 모듈을 통해 지원자의 직무/인성을 종합적으로 평가

구분	검사 내용
직무 면접	직무 지식 및 직무 적합도 검증
인성 면접	LG Way 형 인재 검증

● 지원 분야

본부	직무	주요 업무/역할	관련 전공					근무지
			전자/전자	기계	컴퓨터/SW	소재/재료	기타전공	
H&A본부	HW	- Sensor Application, 구동 Drive, 모터 응용 설계(전동기 설계 및 제어, 인버터, IH) 등	●	●				창원
	SW	- 시스템 알고리즘 (지능제어, 신호처리), Smart 기술 등	●		●			
	기구	- 열 유체 유동설계, 구조 설계, 해석 (응용역학, CAD/CAE/CAM, 최적설계) - 강성, 동역학, 피로해석, 진동/소음 분석 및 평가 등		●		●		
소재/생산기술원	HW	- 장비 운영SW, 제어 알고리즘, 영상처리, Machine Vision, 로보틱스 - 고속/무선 신호전송, 파워회로 설계, 마이크로 패키징	●					평택/전국
	SW	- 장비운영 SW, 제어 알고리즘 개발, 영상처리 SW, Machine Vision	●		●			
	기구	- 장비 설계, Lay Out 설계, 정밀 구동부/강성 구조설계, 광학 모듈 설계 - 로보틱스, 구조/충격/강성 해석 및 최적 설계, 열유동/진동소음 설계 및 해석 - 고속/무선 신호전송, 파워회로 설계, 마이크로 패키징		●				
	Production R&D	- 생산시스템 설계/검증, 생산전략 수립/계획 최적화, 제품 Architecture 표준 설계/개발 - 제조지능화 솔루션(Big Data, AI, 머신러닝, 딥러닝 기반), 제조 ICT 플랫폼 - 금속/플라스틱 가공 기술, 플라스틱 및 복합소재 개발/응용, CMF 기술 - 생산요소기술(용접/주조/체결/실링 등), 청정환경솔루션(이물제어, 클린룸 등) - 레이저 응용 가공/ 용접/건조 등 프로세스 개발 및 시뮬레이션 - 레이저 응용 시스템 설계 및 제어 - 레이저 광학 설계 및 응용	●	●	●	●	● (산업공학)	

* 당사 채용계획에 따라 본인이 지원하지 않은 본부/직무/근무지로 검토 및 배치될 수 있습니다.
* 소재/생산기술원의 경우, 소재기술원은 이번 공채를 통해 선발하지 않습니다.